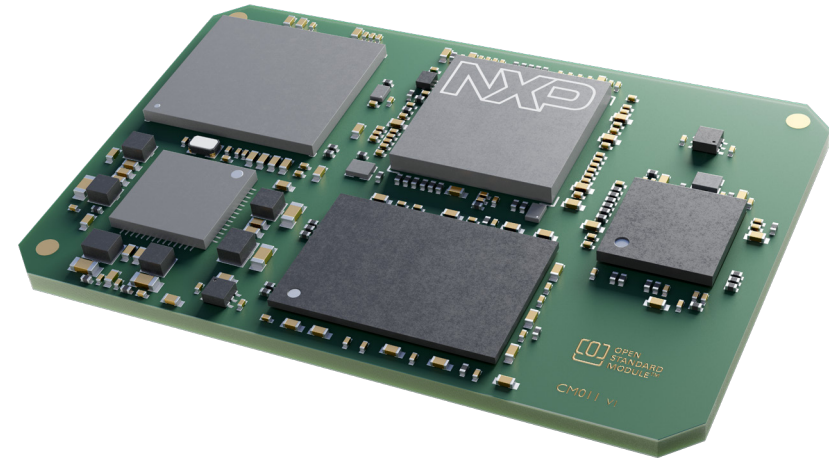


Embedded Module mit NXP i.MX93

Open Standard Module™ - iesy i.MX93 OSM-MF

Technisches Konzept

- ▶ Prozessor: i.MX9352 Dual-Core A55 with NPU + Cortex-M33 MCU
- ▶ Taktrate: 1,7 GHz (A55) / 250 MHz (M33)
- ▶ Arbeitsspeicher: 1 GByte LPDDR4 (Inline ECC)
- ▶ Flash Speicher: 8 GByte e-MMC 5.1
- ▶ Abmessung: 30 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-M
Land Grid Array (LGA) mit 476 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: Single Supply 5 VDC
- ▶ Temperaturbereich:
 - > Im Betrieb: -25 °C bis +85 °C
 - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
 - > 2x Ethernet 1 Gbit (mit TSN)
 - > 2x USB 2.0 Client/Host/OTG
 - > 1x MIPI CSI (2 Lanes, incl. I2C)
 - > 1x MIPI-DSI (4 lanes) – Up to 1080p/60 FPS
 - > 1x SD-Card + 1x SDIO (4 bit)
 - > 15x GPIO
 - > 2x CAN
 - > 1x I2S
 - > 2x I2C
 - > 2x UART + 1x Debug-UART
 - > 2x ADC-Input
 - > 4x PWM, 1x JTAG, 1x SPI (2x chip select)



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



iesy.com/osm